LAGENAUFBAU HDI (Standard)

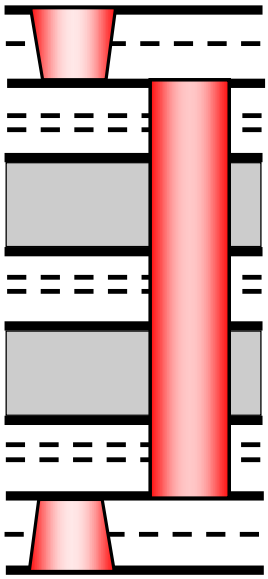
HDI08_1+6b+1_1,25_35

8 - Lagen

Kerne: 0,25 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 6B + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**58**	
2	VSK1		Folie	12 µm		**35**	
					2 x 1080	**133**	
3	2			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
4	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
5	4			35 µm		**33**	
			0,250 mm			**250**	
6	5			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**133**	
7	RSK1		Folie	12 µm		**35**	
					1 x 1080	**58**	
8	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Endkupferdicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1232

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,25**	+/-	0,10	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,34	+/-	0,13	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,40	+/-	0,15	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
25.04.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	Seite:	15+